

EVG signs a contract with PMT to supply maskless lithography systems - January 24, 2024

PMT has ordered a LITHOSCALE® maskless exposure system from EVG. The LITHOSCALE system will be installed at PMT’s headquarters in Asan-si, Chungcheongnam-Do, South Korea, where it will be used in the production of next-generation MEMS-based probe cards for wafer-level testing of advanced NAND, DRAM and HBM devices. According to Young-Sik Yun, general manager of EV Group Korea, “Wafer-level testing with probe cards is an essential process for improving device production yields and reducing overall test cost per die. LITHOSCALE offers a unique combination of high resolution, high flexibility to handle many different product designs, and low cost of ownership, making it an ideal solution for manufacturing fine-pitch wafer probe cards. We are pleased to support PMT in their efforts to expand their product portfolio and shorten their development cycles.”

Digital Today

편집 2024-01-29 10:15 (목) 로그인 회원가입 내역조회

정보미디어 게임-인터넷 블록체인 AI-엔터프라이즈 산업 모빌리티



산업

EVG, 피엠티와 마스크리스 노광 시스템 공급 계약 체결

4대면 기사 입력 2024.01.24 10:44

댓글 0 0



리소스케일 마스크리스 노광 시스템(사진: EVG)

[디지털투데이 4대면 기사] 웨이퍼 본딩 리소그래피 장비 제조 전문 기업 EV그룹(이하 EVG)가 반도체 웨이퍼 프로브 카드 기업 피엠티(PROTEC MEMS Technology)와 리소스케일(LITHOSCALE) 마스크리스 노광 시스템에 대한 공급 계약을 체결했다고 24일 밝혔다.

이번 계약을 통해 EVG는 리소스케일 시스템을 중남 아산시에 위치한 피엠티 본사에 설치한다. 첨단 NAND, DRAM, 고대역폭 메모리 (HBM) 디바이스의 웨이퍼 레벨 테스트용 차세대 MEMS 기반 프로브 카드 제조에 사용될 예정이다.

EVG의 MLE™(Maskless Exposure) 기술을 적용한 리소스케일 시스템은 실시간 데이터 전송과 함께 디지털 프로세싱으로 즉각적인 노광이 가능하다. 또 기존 리소그래피 방식의 병목 문제를 해결하기 위해 높은 구조적 분해능 및 생산 처리량 확장성을 갖췄다.

특히 MEMS 제조에서 마스크를 사용하지 않는 리소스케일은 높은 초점 심도와 고분해능(2m 수준의 1/50 line&Spaces)을 지원해, 마스크를 사용하지 않고도 미세 피치 프로브 카드의 핵심 기술인 고밀도 재배선 레이아웃과 비어(Void) 연결이 가능하다.

조용호 피엠티 대표는 “EVG의 마스크리스(Maskless) 노광 장비인 LITHOSCALE로 대체함으로써 제조 비용의 절감이 가능하고, 공정 개발 속도 또한 혁신적으로 더욱 가능할 뿐 아니라 프로세스 성능도 더욱 향상할 수 있을 것”이라며 “앞으로도 우리는 첨단 프로브 카드 제조 및 개발에 있어 EVG의 LITHOSCALE뿐 아니라 다양한 프로세스 솔루션을 통한 협력을 이어갈 것으로 기대한다”고 말했다.

윤영식 EVG 한국지사장은 “프로브 카드를 사용하는 웨이퍼 레벨 테스트는 디바이스 생산 수율을 높이고 다량 생산을 위한 테스트 비용을 낮추기 위해서 필수적인 공정”이라며 “리소스케일은 높은 분해능, 다양한 얇은 계층을 처리할 수 있는 뛰어난 유연성, 낮은 소유 비용을 결합한 독창적인 솔루션으로서 미세 피치 웨이퍼 프로브 카드 제조용으로 매우 이상적”이라고 말했다.